

Halbleiter Ptfе Reinigungskorb 12-Zoll Wafer Nassätzgestell Säure- Und Alkalibeständiger Fluorpolymer-Träger

Artikelnummer: PL-CP81



Einführung

Entwickelt für hochreine Halbleiterumgebungen bietet dieser 12-Zoll PTFE-Wafer-Reinigungskorb außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit bei kritischen Nassätz- und Reinigungsverfahren. Das kundenspezifisch gefertigte Design sorgt für zuverlässige Waferunterstützung und maximale Flüssigkeitszugänglichkeit für präzise Fertigung.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
RCA-Reinigung	Standardisierte Sequenz (SC-1 und SC-2) zur Entfernung von organischen Kontaminationen und metallischen Verunreinigungen.	Verhindert Rückkontamination bei Übergängen zwischen hohen und niedrigen pH-Werten.
HF-Ätzung	Entfernung von Opferoxidschichten oder nativen Oxiden mit Flußsäurelösungen.	Vollständige Unempfindlichkeit gegen HF-Angriff gewährleistet eine lange Lebensdauer des Geräts.
Piranha-Ätzung	Hochtemperaturgemisch aus Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid zur Entfernung von Photoresist.	Hält extremen exothermen Reaktionen stand ohne strukturelle Erweichung.
Post-CMP-Spülung	Entfernung von Schleifpartikeln und Chemikalien nach dem chemisch-mechanischen Polieren.	Minimale Kontaktpunkte verhindern Partikelfang hinter dem Wafer.
Solarzellen-Texturierung	Säure- oder alkalische Texturierung von großformatigen Siliziumwafern zur Verbesserung der Lichtabsorption.	Haltbarkeit für hohe Stückzahlen in Umgebungen mit dauerhafter Chemikalienbelastung.
MEMS-Fertigung	Tief Nassätzung von Silizium- oder Glassubstraten zur Herstellung mikromechanischer Strukturen.	Gewährleistet gleichmäßige Ätzraten durch optimierte Flüssigkeitszirkulation.
Photolithographie	Entwicklung und Stripping von Photoresistmaterialien mit spezialisierten organischen Lösungsmitteln.	Lösungsmittelbeständiges Material verhindert das Auslaugen von organischen Stoffen in den Entwickler.
Megasonische Reinigung	Hochfrequenz-Schallreinigung zur Entfernung von submikrometrischen Partikeln von Waferoberflächen.	Die Materialdichte überträgt akustische Energie effektiv ohne Dämpfungseffekte.

Merkmal	Spezifikationsdetail (PL-CP81)
Hauptmaterial	Hochreines jungfräuliches PTFE (Polytetrafluorethylen)
Kompatibilität Waferdurchmesser	300mm (12-Zoll) – kundenspezifische Größen auf Anfrage verfügbar
Konfiguration	Einzelwaferträger / Mehrfachwafer-Blumenkorbbkonfiguration
Fertigungsverfahren	Präzise CNC-Bearbeitung / Kundenspezifische Fertigung
Chemikalienbeständigkeit	Voller Bereich (pH 0-14); beständig gegen HF, HNO ₃ , HCl, H ₂ SO ₄ , KOH, etc.
Betriebstemperatur	Kontinuierlicher Einsatz bis 260°C (kundenspezifische Grenzwerte je nach Design)
Schlitzabstand	Vollständig anpassbar an Anforderungen an Flüssigkeitsfluss oder Kapazität
Kontaktart	Punktkontakt- oder Randkontaktdesigns verfügbar

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Merkmal	Spezifikationsdetail (PL-CP81)	
Griffoptionen	Fixiert, abnehmbar oder automatisierte Roboterflanschschnittstelle	
Oberflächenfinish	Extrem glattes bearbeitetes Finish zur Minimierung der Partikelanhaftung	
Reinheitsstandard	Halbleiterkonform; Spurenmetallanalyse verfügbar	